关于重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2020 年重庆市永川区惠通建设发 展有公司双创孵化专项债券 分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示:

债权登记日: 2025年4月29日

本金偿还日: 2025年4月30日

本次偿还比例: 20%

重庆市永川区惠通建设发展有限公司的相关证券分期偿还情况如下:

单位:元

证券代码	证券 简称	调整前 债券面值	调整后 面值生效日	调整后 债券面值	本次偿还比例(%)
152492	20 惠通 01	60. 00	2025 年 4 月 30 日	40.00	20

发行人将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务,及时对 **2020** 年重庆市永川区惠通建设发展有公司双创孵化专项债券事项进行公告。

特此公告。

重庆市永川区惠通建设发展有限公司

2025年4月21日

本页无正文,为《关于重庆市永川区惠通建设发展有限公司 2020 年重庆市 永川区惠通建设发展有公司双创孵化专项债券分期偿还本金公告》盖章页



2025年4月 21 日